

# 電子材料研究会

〔委員長〕川浪仁志（産総研）

〔副委員長〕奥村次徳（都立大）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大），羽路伸夫（横浜国大）

日時 5月17日（金）10：00～16：30

場所 自動車会館2階会議室（東京都千代田区九段南4-8-13，JR中央線，営団地下鉄有楽町線・南北線，都営地下鉄新宿線，いずれも市ヶ谷駅より徒歩約3分，Tel 03-3264-4791）

協賛 ULSI用金属材料技術調査専門委員会（委員長 財満鎮明，幹事 山本直樹，大場隆之，幹事補佐 酒井 朗）

議題 テーマ「実装技術『Seamless Interconnect LSIから実装配線まで』」

はじめに - ULSI用金属材料技術調査専門委員会解散報告 -

財満鎮明（名古屋大）

EFM 02 1 オンチップ配線技術の現状と課題

上野和良（日本電気）

EFM 02 2 分布定数回路 - ボードからLSI内部へ -

碓井有三（マクニカ）

EFM 02 3 超高周波化合物半導体集積回路

松浦裕之，小林信治，八木原 剛，三浦 明（横河電機）

EFM 02 4 パッケージ技術の最前線

若林信一（新光電気）

EFM 02 5 めっき技術の最前線

- 次世代デバイス・実装のためのウェットプロセス技術の展望と課題 -

本間敬之（早稲田大）

EFM 02 6 実装技術の最前線 - チップ貫通電極形成技術 -

富坂 学，米村 均，星野雅孝，高橋健司（ASET）

EFM 02 7 実装技術の最前線 - 微細ピッチ接続技術 -

高橋健司（ASET）

EFM 02 8 光実装の最前線 - 基板・チップ間光コネクタ技術 -

平松星紀（ASET）